

性能特点

- 高导热、低应力、低模量
- 不固化,可重工
- 可用于自动点胶
- 本身粘稠状,触变性好,不流淌,与接触器件 粘合性好,接触热阻低、耐振动性好
- 优越的耐高低温、耐气候、耐老化及电绝缘性

产品描述

PAKCOOL® TG-510-KJ 系列可挤导热泥状态介于硅脂和橡皮泥状之间,易于涂抹和挤出或自动点胶,填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间,使其紧密接触、减小热阻,快速有效地降低电子原件的温度,从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

该产品具有良好的触变性,胶料点胶时不滴落,涂抹时不任意流淌。进行缝隙填充时,使用厚度达到 2mm 时耐振动性仍然良好。

典型应用

- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 激光设备
- LED 照明
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

 如客户需要更详细的说明,请与我公司市场销售 部联系。他们会随时为您解答和服务。

技术参数

特性	TG-510-KJ	测试方法
外观	白色	-
粘度 (cP)	95万±35万	ASTM D2196-15
导热系数 (W/m·K)	1.0	ASTM D5470
密度 (g/ cm³)	2.60 ± 0.10	ASTM D792
挥发物 (% @150℃×3hrs)	≤0.35	GB 33372-2020
阻燃	V-0	UL 94
连续使用温度(°C)	-50~+200	-

本数据仅可用于指导,并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 被涂器件材质如果吸油性很大,会使胶料状态有明显变厚变干的现象。故需表面处理为不吸油的器件,或用我司单组分胶表面涂抹以进行防吸油处理。器件材质不吸油的判断一般以常温涂上胶料 24 小时后状态无明显变化即可。
- 清洁涂覆件表面,取出足够量的本产品,通过 挤出、涂抹或自动点胶填充于需冷却的电子元件与散热 器/壳体等之间,使其紧密接触。每次用完应密封以备 后用。

包装储运

- 本产品可提供 30mL、55mL 点胶针筒, 330mL 胶瓶, 1Kg、5Kg 和 20Kg 的桶装,或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不燃材料,桶装产品室温下的储存期约12个月。如有在储藏期间有渗油出现,应将其搅拌均匀后使用;支装产品由于无法搅拌,应平放,储存条件:在<25℃环境下保存不超过2个月,在<0℃环境下保存不超过6个月;使用前应在25℃条件下回温至少4小时,使胶料温度与使用环境温度一致后再使用。
 - 可以作为一般液体化学品运输。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异,所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时,一定要先进行测试,以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题,欢迎和我司技术部门联系,我们将尽力为您提供帮助。